

COMUNICATO STAMPA

LSI annuncia un link layer processor di nuova generazione per reti WAN

Il design unificato della scheda consente costi contenuti, supporto multiprotocollo e scalabilità

MILPITAS, California, 16 febbraio 2009 – LSI Corporation (NYSE: LSI) ha annunciato oggi la sua nuova generazione di LLP (link layer processor), un'importante nuova aggiunta alla famiglia LSI™ di elaboratori multiservizio. Il nuovo LLP SoC (system-on-chip) a design unificato supporta tutti i principali protocolli ed è scalabile sull'intero spettro dell'ampiezza di banda, da T1/E1 a STM-1, in modo che un solo sforzo di sviluppo da parte degli OEM può ora essere sfruttato per tutti i più importanti livelli di servizio e prestazioni.

“L'industria delle telecomunicazioni sta subendo forti pressioni per integrare diversi tipi di traffico,” ha dichiarato Jag Bolaria, analista senior del The Linley Group. “L'LLP di LSI rende tale integrazione sia economica che tecnicamente possibile su larga scala.”

Sino a oggi gli OEM del settore telecomunicazioni erano costretti ad acquistare e integrare schede individuali per ciascuna tipologia principale di servizio. L'LLP di LSI opera su una piattaforma hardware e software comune e altamente scalabile, che riduce sia i tempi di sviluppo che il numero di schede richiesto per fornire più servizi di rete. Oggi gli OEM sono in grado di sfruttare un solo design per più applicazioni, quali stazioni base wireless, trasporto wireless e radiocontroller di rete high-end.

“Il complesso mix di protocolli e applicazioni che gira sulle attuali reti avanzate richiede SoC multicore altamente integrati, allo stato dell'arte e con software conforme agli standard telecom,” ha detto Jim Anderson, vicepresidente per vendite e marketing del Semiconductor Solutions Group di LSI. “Il nostro LLP di ultima generazione dà agli OEM una piattaforma unica, scalabile e altamente efficiente che permette loro di costruire stazioni base multiservizio per reti 2G, 3G e 4G.”

Fra le applicazioni wireless, il SoC LLP supporta un carico di traffico sia BTS (2G) che Node B (3G) verso BSC (2G) e RNC (3G). Allo stesso modo, il nuovo LLP multicore permette il trasporto di protocolli legacy multipli su reti a pacchetto cablate. L'efficienza della rete viene massimizzata poiché l'LLP continua a far funzionare i moduli WAN in caso di riavvio di sistema e passa automaticamente alle capacità di backup se avviene un guasto di sistema che potrebbe altrimenti interferire sul traffico. Il risultato è una rete molto efficiente, in grado di fornire servizi any-to-any multipli.

Il SoC LLP fornisce un'ampia gamma di supporti multiservizio fra cui Metro Ethernet, IP, MPLS, edge-to-edge pseudo-wire emulation (PWE3) su protocolli CESoPSN, SAToP, ATM, TC/IMA, HDLC/MLPPP, AAL1, frame relay e Transcoder Rate Adaptation Unit (TRAU).

Il nuovo link layer processor di LSI è già disponibile. LSI dimostrerà le proprie soluzioni per infrastrutture wireless presso lo stand AV53 del GSMA Mobile World Congress di Barcellona, Spagna, dal 16 al 19 febbraio. Lo stand LSI si troverà nell'Avenue Pavilion, vicino al padiglione 8 della fiera.

Chi è LSI Logic

LSI Logic Corporation (NYSE: LSI) è uno dei principali produttori di soluzioni, dal silicio al sistema, alla base di prodotti che creano, memorizzano e trasportano informazioni digitali. LSI offre un



www.lsi.com

ampio catalogo di possibilità che comprende adattatori host bus e RAID, IC, prodotti standard e chip personalizzati, soluzioni SAN e software applicativi. I prodotti LSI permettono alle più importanti aziende tecnologiche del mercato Storage e Networking di offrire alcuni dei più noti e avanzati sistemi elettronici oggi in vendita. Ulteriori informazioni si trovano su www.lsi.com.

Editor's Notes:

1. All LSI news releases (financial, acquisitions, manufacturing, products, technology, etc.) are issued exclusively by PR Newswire and are immediately thereafter posted on the company's external website, <http://www.lsi.com>.
2. LSI and the LSI logo design are trademarks or registered trademarks of LSI Corporation.
3. All other brand or product names may be trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Ufficio Stampa Italia

Cynthia Carta Adv.

Advertising Communication

Via Monte Rosa, 74 – 20149 Milano

Ph. ++39(0)2 45484666 Fax ++39(0)2 45484685 Mobile ++39 3385909592

e-mail cyncarta@cynthiacartaadv.it www.cynthiacartaadv.it